

## **盛合晶微半导体有限公司**

# **关于东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目将于 近日开工建设的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

● 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第一届董事会第四次会议、2024 年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设盛合晶微临港先进封装产线项目的议案》，同意公司投资建设东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目（以下简称“本项目”）。项目总投资约 100 亿元，最终投资金额以项目实际投入为准，公司将根据项目建设进展按需投入。

● 目前项目正在积极筹备开工前各项事宜，待近日完善相关手续后将于 6 月 29 日正式开工建设。

### **● 相关风险提示：**

1、本项目系公司基于发展战略、市场需求及行业前景综合研判后拟实施，项目落地与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及专业人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

2、本项目投资规模、实施进度等均为公司基于当下情况的合理预估或计划，存在一定的不确定性，不构成公司对未来的业绩预测，亦不构成公司对股东的业绩承诺。

3、本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式，虽然公司具有一定的资金实力且银行信用良好，

但项目投资及建设过程中，若资金筹措、信贷政策等发生变化，可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

4、本项目的后续进展情况如发生较大变化，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、项目投资的基本情况

公司于2024年11月20日召开第一届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设盛合晶微临港先进封装产线项目的议案》。为进一步强化公司在芯粒多芯片集成封装领域的竞争地位，扩充超高密度互联三维多芯片集成封装产能，加速前沿研发成果的产业化落地，并实现前瞻布局，公司拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资建设东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目。项目的基本情况如下：

（一）项目名称：东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目（项目备案名称）

（二）实施主体：东盛合芯科技（上海）有限公司

（三）项目建设地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

（四）投资规模：预计项目总投资约100亿元，最终投资金额以项目实际投入为准，公司将根据项目建设进展按需投入。

（五）资金来源：公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式。

（六）建设内容：3DIC 规模量产产能

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目投资的必要性及对公司的影响

本次投资建设东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目是执行并落地公司“致力于发展先进的芯粒多芯片集成封装测试一站式服务能力”发展战略规划，完善公司先进封装技术平台布局的重要一步。3DIC 技术路径可为客户提供更高的设计灵活性，是支撑高性能芯片异构集成与系统扩展的关键技术之一，前瞻规

划布局规模量产能力，有利于公司前沿科技成果加速产业化，有利于公司充分发挥前中后段芯片制造经验的综合性优势，在后摩尔时代与客户紧密合作，满足高算力、高带宽、低功耗等全面性能提升对先进封装的综合性需求，抢抓先进封装市场发展机遇，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司长期发展规划。

本项目投资的资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式。项目建设资金将根据经营规划、项目建设进度合理把握投资节奏，有序分批投入。公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，短期内也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 三、项目进展情况

公司已与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会签署《战略合作备忘录》《投资扶持协议》，并已完成项目实施主体东盛合芯科技（上海）有限公司的注册，初始注册资本 1.4 亿美元。

目前项目正在积极筹备开工前各项事宜，待近日完善相关手续后将于 6 月 29 日正式开工建设。

### 四、相关风险提示

（一）本项目系公司基于发展战略、市场需求及行业前景综合研判后拟实施，项目落地与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及专业人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

（二）本项目投资规模、实施进度等均为公司基于当下情况的合理预估或计划，存在一定的不确定性，不构成公司对未来的业绩预测，亦不构成公司对股东的业绩承诺。

（三）本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式，虽然公司具有一定的资金实力且银行信用良好，但项目投资及建设过程中，若资金筹措、信贷政策等发生变化，可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

（四）项目的后续进展情况如发生较大变化，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年6月27日